

DEM-2003

Insulation resin for Casting



DEM-2003 产品是以环氧和变性胺树脂为主要成分的卓越的铸模用产品，表现卓越的黏着力、柔软性、耐水性，是适合一般零部件成型用的产品。

用途

电子零部件铸模用

产品特性

增光剂类型	2 液型环氧树脂类型		
产品特性	1 作业性卓越。 2 热冲击性卓越。 3 电气特性值卓越。 4 黏着力卓越。		
稀释剂	无	可使用时间 (25°C) (A+B)	12 小时
外观	浅黄色		
黏度	100~140 POISE	硬化条件	25°C×24 小时 / 60°C×4 小时
比重	1.48±0.02	UL 认证	非认证
上 GEL TIME(60°C)	30 ~ 40 MIN	产品保存条件	在通风较好的阴凉室内保存
混合比	A : B = 100 : 20 (重量)	产品有效期限	自生产日起 6 个月 (符合保存条件时)

产品特征 (物性 DATA)

绝缘破坏电压	20 KV/mm 以上
体积电阻率	$1.0 \times 10^{14} \Omega\text{cm}$ 以上
硬度	60 ~ 70(SHORE-D)
吸湿性	0.03% 以下

使用方法

使用方法	1 按照规定的混合比混合后均匀搅拌。 2 混合后真空脱泡，去除气泡。 3 向树脂中注入均匀混合的环氧。 4 按照规定的硬化条件硬化。
特别事项	1 上述使用方法根据材料的类型及 LINE 条件可能有所不同。 2 请熟知 MSDS 后使用产品。

▶ 上述资料依据实验室条件制作而成，根据作业方法及情况，产品的物性可能有所不同。以上物性请仅作为参考资料使用。